

取付基板寸法
RECOMMENDED P.C BOARD LAYOUT

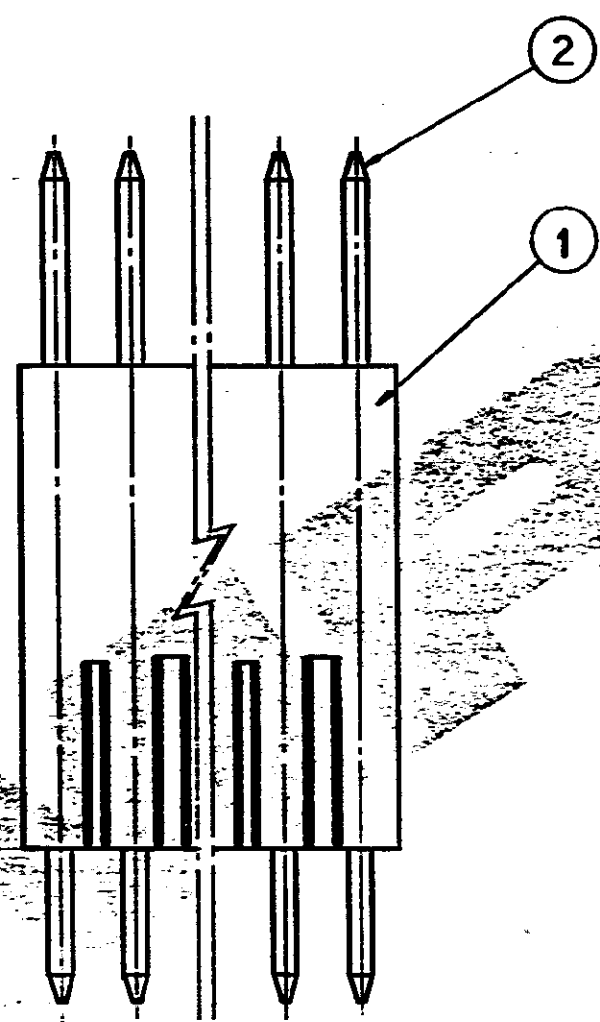
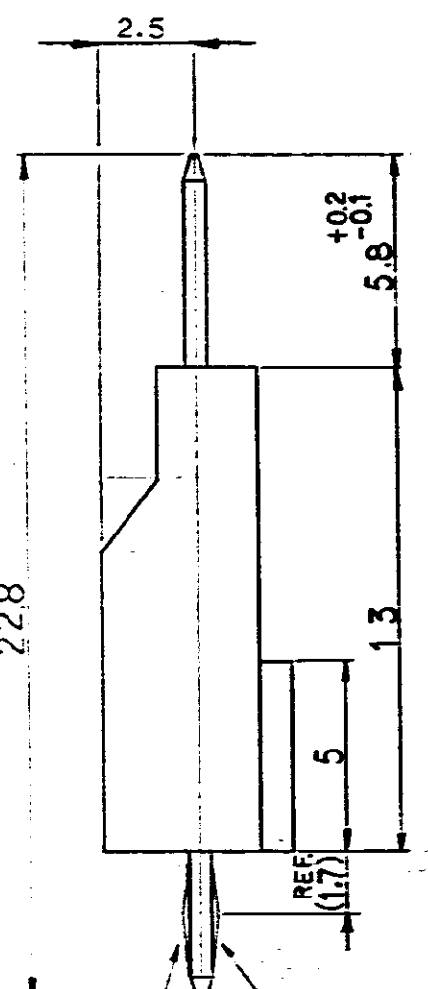
注:
1. 通用製品規格: 108-5221
2. キング加工位置は表1参照。
3. 適用基板厚 1.6
△パンチ加工の場合、基板のクラック発生に対し充分配慮して加工してください。

表 2 (TABLE 2)

名称 (NAME)	材質表面処理 (MATERIAL & FINISH)
① ハッパヘッド (HEADER HOUSING)	6/6 ナイロン (94V-0) (6/6 NYLON)
② ポストコンタクト (POST CONTACT)	錫メッキ黄銅 (PRE TIN BRASS)

NOTES:
1. PRODUCT SPEC: 108-5221
2. KINKING POSITION (SEE TABLE 1)
3. APPLICABLE P.C.B THICKNESS 1.6
△ MUST CONSIDER TO PREVENT CRACK OF P.C.B AT PROCESSING THE METHOD OF PUNCHED HOLE.

黒 (BLACK)	-18	-16	9	174075-9
色 (COLOR)	10	8	5	174075-5
	L	N	極数 (POS)	型番 (P/N)
	寸法 (DIMENSION)			



キング形状B
(KINKING FORM)
キング形状A
(KINKING FORM)
キング加工位置
(TABLE 1: KINKING POSITION)

回路 No CIRCUIT No.	キング位置及び形状 (KINKING POSITION)								
極数 (POS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	(B)	-	(A)	-	(B)	-	-	-	-
9	-	-	(B)	-	(A)	-	(B)	-	-

C	変更 (FJD0-0081-03)	T.H.	M.S.	08APR 2003
B	変更 (J-10143)	M.S.	10/10	5/85
A	変更 (J86-9226)	T.A.M.S.	3/20	3/85
O	作成 (J86-9195)	T.A.M.S.	1/25	1/85
LTR	RE (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE		INSULATION DIA		SER NAME	
AWG		-		B-B インター B-B インター (20mm ピッチ) ポスト ハッパ アッセンブリ	
MATERIAL		FINISH		BOTTOM ENTRY B-B CONN. 20mm PITCH POST HDR ASSY	
表2参照 (SEE TABLE 2)		表2参照 (SEE TABLE 2)		-公差	
DR Y. Ikada 1/29/85		DE M. Shindo 1/29/85		SIZE	LOC
CHK M. Simas 1/29/85		APP J. Oshida 1/29/85		B	J
				C-174075	
				REV	SHEET
				5:1	C
				1/1	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)